



平成 29 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 P A L T E K
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 矢 吹 尚 秀
(東証第二部・コード 7587)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 オ ン ラ イ ン サ ー ビ ス 井 上 博 樹
テ ィ ビ シ ョ ン 本 部 長
T E L 0 4 5 - 4 7 7 - 2 0 0 0

主要仕入先であるザイリンクス社製品販売における取引形態変更 に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 11 月 28 日付で、当社の主要仕入先である米国 Xilinx, Inc. (以下「ザイリンクス社」という) 製品販売において、平成 30 年 1 月より一部の主要大手顧客への販売活動のうち販売・物流オペレーション業務のみを担当し、それ以外の FPGA 活用ニーズの調査、案件発掘、案件獲得、技術サポートに関する業務はザイリンクス社が担当することを、ザイリンクス社との間で合意いたしました。なお、主要大手顧客以外の顧客については、従来どおり当社にてすべての販売業務を行います。これにより、当社グループの将来の業績に対して短期的に影響が生じることとなりましたので、お知らせいたします。

なお、本件および今後に向けた取り組みに関する補足説明資料「主要仕入先との取引形態変更および今後の取り組み」を別途公表しておりますので、あわせてご覧ください。また、説明資料に関する機関投資家・アナリスト向け説明会を平成 29 年 11 月 30 日 (木) 11 時より開催いたします。説明会に関する詳細については本資料の最後に記載しております。加えて、補足説明資料に関する動画説明も当社のウェブサイトに掲載する予定です。

1. 当該事象に至った経緯

近年、半導体の微細化技術の進化により半導体の高度化が加速しています。中でも FPGA (Field Programmable Gate Array) の進化は目覚しく、FPGA メーカーのザイリンクス社は最先端の半導体プロセスを用いて非常に大規模、高速かつ低消費電力な製品を提供しています。FPGA は通信インフラ分野や産業機器分野などで幅広く採用されておりますが、さらに新たな領域として車載、インダストリアル IoT、クラウドコンピューティング分野などでの採用が広がっています。新たな市場を創出する場合には製品のコンセプトレベルでのサポートが重要となるため、メーカーによる直接的なサポートの必要性が増加しています。また、代理店が行う技術サポートでも、技術的に非常に高度なサポートについてはメーカーでの直接サポートが必要であり、その頻度も高くなってきています。その中で、高機能な FPGA のプロモーション時や FPGA 採用決定後の技術サポート負荷は増大しており、収益とバランスの取れたプロモーション、技術サポートは難しくなっています。一方、日本以外の市場における FPGA の販売については、メーカーであるザイリンクス社が案件発掘、案件獲得、技術サポートなどを行い、代

理店が物流業務を行うことが主流になっています。

今般、上述の背景により、当社は平成 30 年 1 月より一部の主要大手顧客におけるザイリンクス社製品の販売活動に関して、販売・物流オペレーション業務のみを担当し、それ以外の FPGA 活用ニーズの調査、案件発掘、案件獲得、技術サポートに関する業務はザイリンクス社が担当することを、ザイリンクス社と合意いたしました。なお、主要大手顧客以外の顧客については、従来どおり当社にてすべての販売業務を行います。また、当該取引形態変更に関する業務内容の詳細につきましてはザイリンクス社と引き続き協議を進めております。当該取引形態変更の対象顧客に関するザイリンクス社への業務引継ぎについては今後実施してまいります。

2. ザイリンクス社の概要

(1) 名 称	Xilinx, Inc. (米国ナスダック上場)		
(2) 所 在 地	米国カリフォルニア		
(3) 代表者の役職・氏名	President and CEO Moshe Gavrielov		
(4) 事 業 内 容	All Programmable FPGA・SoC・3D IC の設計、開発、販売及び次世代設計環境や IP の提供、サポート		
(5) 資 本 金	2,480 千 US ドル (2017 年 4 月 1 日)		
(6) 設 立 年	1984 年		
(7) 連 結 純 資 産	2,507,633 千 US ドル (2017 年 4 月 1 日)		
(8) 連 結 総 資 産	4,740,532 千 US ドル (2017 年 4 月 1 日)		
(9) 上 場 会 社 と 当 該 会 社 の 関 係	資 本 関 係	該当事項はありません	
	人 的 関 係	該当事項はありません	
	取 引 関 係	同社製品の仕入及び販売	
	関連当事者への該当状況	該当事項はありません	

3. 取引の内容

取引の種類	平成 28 年 12 月期	
	同社製品の売上高	連結売上高に対する比率
ザイリンクス社製品の仕入及び販売	11,783 百万円	35.1%

4. 今後の見通し

当該取引形態の変更は平成 30 年 1 月からとなるため、平成 29 年 12 月期の当社業績に与える影響はありません。

平成 30 年 1 月以降、主要大手顧客向けの FPGA 販売活動が販売・物流オペレーション業務のみになることで、当該販売における売上総利益率は大幅に低下するため、今後の業績に対して短期的に影響が生じることとなります。当該販売の対象となる主要大手顧客における平成 29 年 12 月期の想定売上高をベースに考えると、平成 30 年 12 月期への売上総利益の影響額は、平成 29 年 12 月期から最大で約 7.5 億円減少することが想定されます。なお、売上高につきましては、販売は当社から行うこととなるため、当該合意に基づく売上高の減少はありません。

当社グループはかねてから収益性を向上させるために、半導体事業をベースとし設計開発受託や量産製造受託を行う「デザインサービス事業」を成長事業として注力し、そして半導体販売やデザインサービスで培ったシステム提案力・技術サポート力をベースとし、最終製品レベルでソリューション提案を行う「ソリューション事業」を新規事業として立ち上げております。今回の **FPGA** ビジネスの取引形態変更により、変更対象となるお客様向けに対応していたリソースをデザインサービス事業やソリューション事業に振り向けることで、これらの事業展開を強化します。また、半導体事業においても、日本において特長ある技術を有しグローバルで競争力のある製品を開発している企業に対して技術提案力に優れたリソースを投入することが可能になり、各種半導体製品の販売を一層強化します。また、これまで培ってきた **FPGA** に関する設計・開発力を活用し、**FPGA** をベースとしたソリューションの開発および販売を加速してまいります。

当該合意に基づき、平成 30 年 12 月期の営業利益は約 5 億円に減少する可能性があります、上記の施策を実行することにより収益性の高い事業を強化することができるため、当社グループは中期目標として掲げておりますように、引き続き平成 32 年 12 月期での売上高 400 億円、営業利益 20 億円、営業利益率 5%の達成を目指してまいります。

なお、今回の「ザイリンクス社製品販売における取引形態変更」を受けての今後の取り組みについて、補足説明資料を公表しております。詳細につきましては、本日公表の「主要仕入先との取引形態変更および今後の取り組み」をご覧ください。

以 上

(参考 1) 当期連結業績予想 (平成 29 年 8 月 3 日公表分) および前期連結実績

	連結売上高	連結営業利益	連結経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
当期連結業績予想 (平成 29 年 12 月期)	32,500 百万円	1,050 百万円	1,060 百万円	700 百万円
前期連結実績 (平成 28 年 12 月期)	33,544 百万円	515 百万円	110 百万円	11 百万円

(参考 2) 説明会の開催について

当社は、「主要仕入先との取引形態変更および今後の取り組み」について機関投資家・アナリスト向けの説明会を以下のとおり開催いたします。なお、個人投資家の皆様におかれましては、本日公表の補足説明資料に関する説明動画を当社 WEB サイトに平成 29 年 12 月 1 日に掲載する予定ですので、説明動画をご覧くださいたくお願い申し上げます。

説明会開催日時：平成 29 年 11 月 30 日 (木) 11 時～12 時

説明会開催場所：日本証券アナリスト協会 第 1 セミナールーム
(日経茅場町別館 B1F カンファレンスルーム)

<https://www.nikkei-hall.com/conference/kayabacho.html>